



性能特点

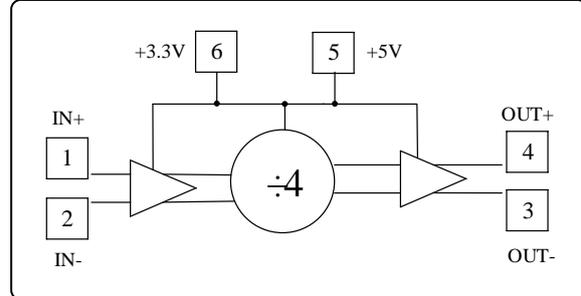
工作频段: 0.1-12 GHz

输出功率: -2 dBm

单电源供电: +5V @ 60 mA, +3.3V @ 55 mA

芯片尺寸: 1.2 × 0.6 × 0.1 mm³

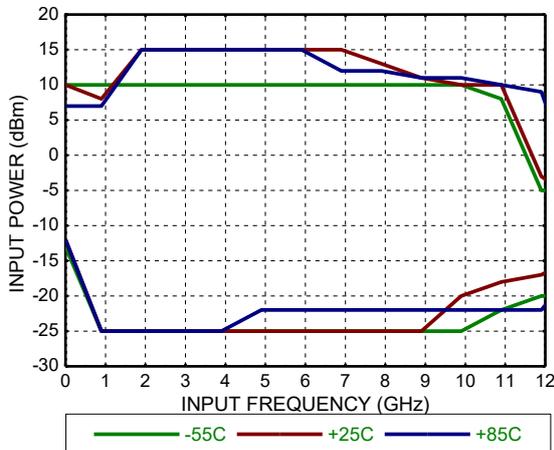
功能框图



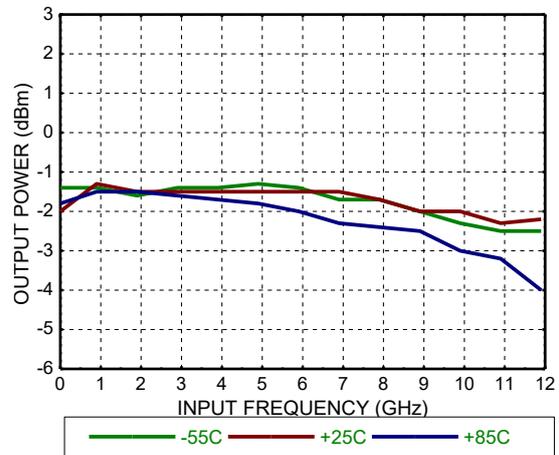
电特性参数 (T_A = +25°C, V_{DD} = +3.3V / +5 V, I_{DD} = 55mA / 60 mA)

参数	条件	最小	典型	最大	单位
最高输入频率	正弦波		12		GHz
最低输入频率	正弦波		0.1		GHz
输入功率范围	f _{IN} = 0.1 – 12 GHz	-20	0	+15	dBm
输出功率	f _{IN} = 0.1 – 12 GHz		-2		dBm
单边带相位噪声	P _{IN} = 0 dBm, f _{IN} = 3 GHz		-150		dBc/Hz
工作电流	+3.3V		55		mA
	+5V		60		

输入灵敏度窗口 vs. 温度

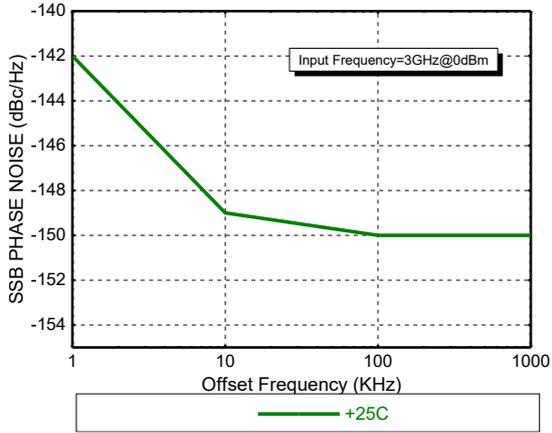


输出功率 vs. 温度

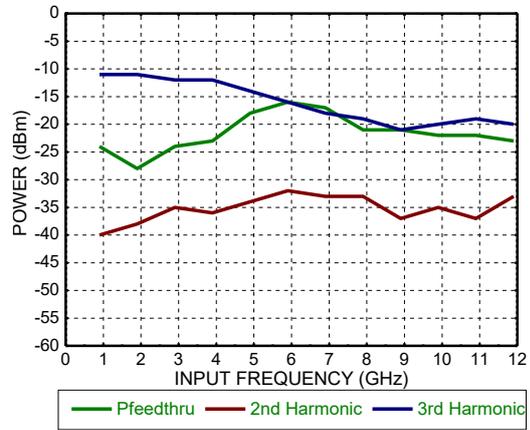




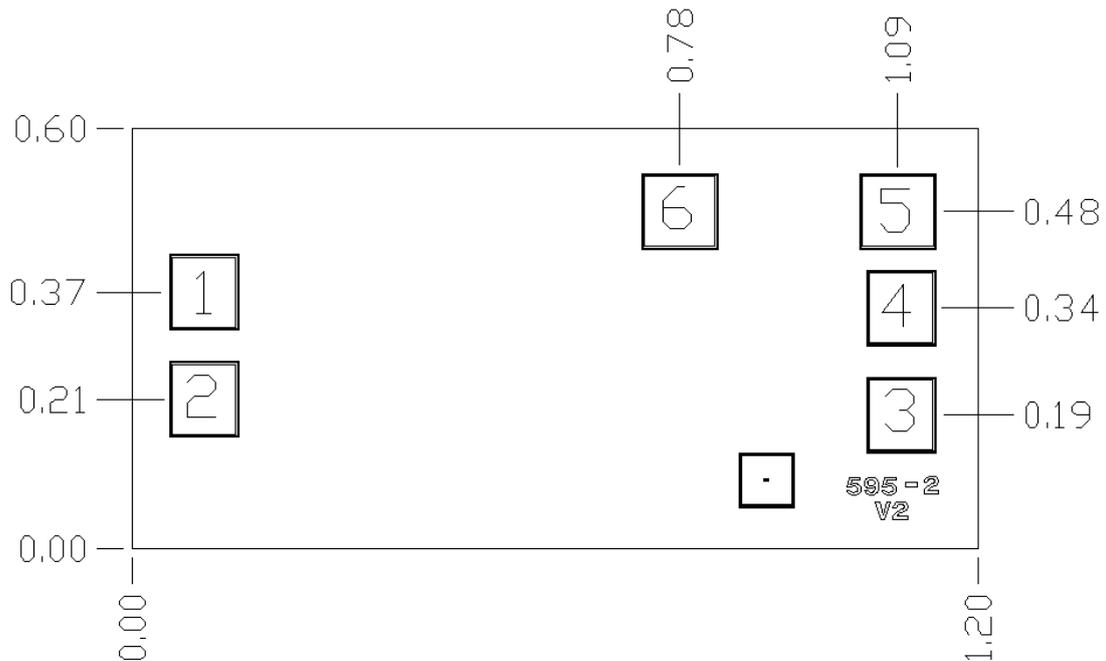
SSB相位噪声, $T=25^{\circ}\text{C}$



输出谐波, $P_{in}=0\text{dBm}$, $T=25^{\circ}\text{C}$

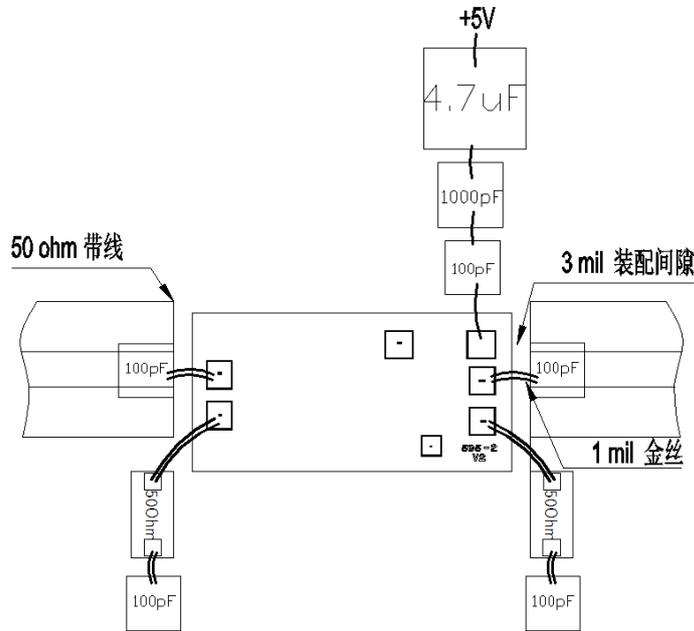


物理参数





装配图



注：该装配图为单端使用情况，如需差分使用，输入输出引脚均需接 100pF 隔直电容。

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN+	该焊盘是射频输入端（需外接 100pF 隔直电容）
2	IN-	该焊盘是射频输入端（单端使用时需外接 50ohm 电阻与 100pF 隔直电容到地）与焊盘 1 相位相差 180°
3	OUT-	该焊盘是分频信号输出端（单端使用时需外接 50ohm 电阻与 100pF 隔直电容到地）
4	OUT+	该焊盘是分频信号输出端（需外接 100pF 隔直电容）与焊盘 3 相位相差 180°
5	+5V	该焊盘是+5V 电源端，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容，+5V 与+3.3V 电源端只需使用其中一个
6	+3.3V	该焊盘是+3.3V 电源端，需要外接 100pF/1nF/4.7μF 旁路电容，+5V 与+3.3V 电源端只需使用其中一个
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至地

极限参数

供电电压：+5.5V（引脚 5）、+3.5V（引脚 6） 储存温度：-65~+150°C 工作温度：-55~+125°C